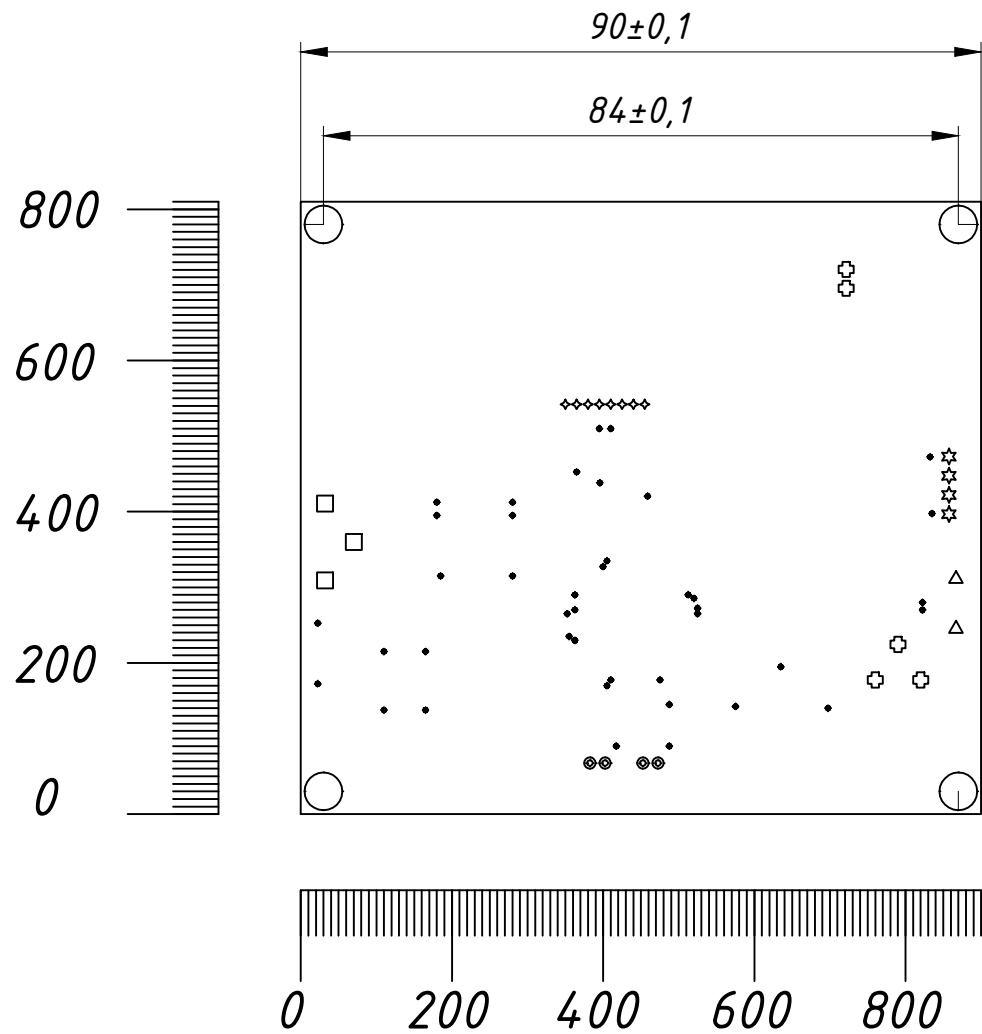




Таблиця 2

Symbol	Count	Hole Size	Plated	Конт.діаметр,мм
⊕	41	0.30mm	Есть	PTH
△	2	0.50mm	Есть	PTH
◇	8	0.80mm	Есть	PTH
⊙	4	0.81mm	Есть	PTH
⊕	5	1.00mm	Есть	PTH
☆	4	1.14mm	Есть	PTH
□	3	1.60mm	Есть	PTH
○	4	3.30mm	Есть	PTH
71 Total				

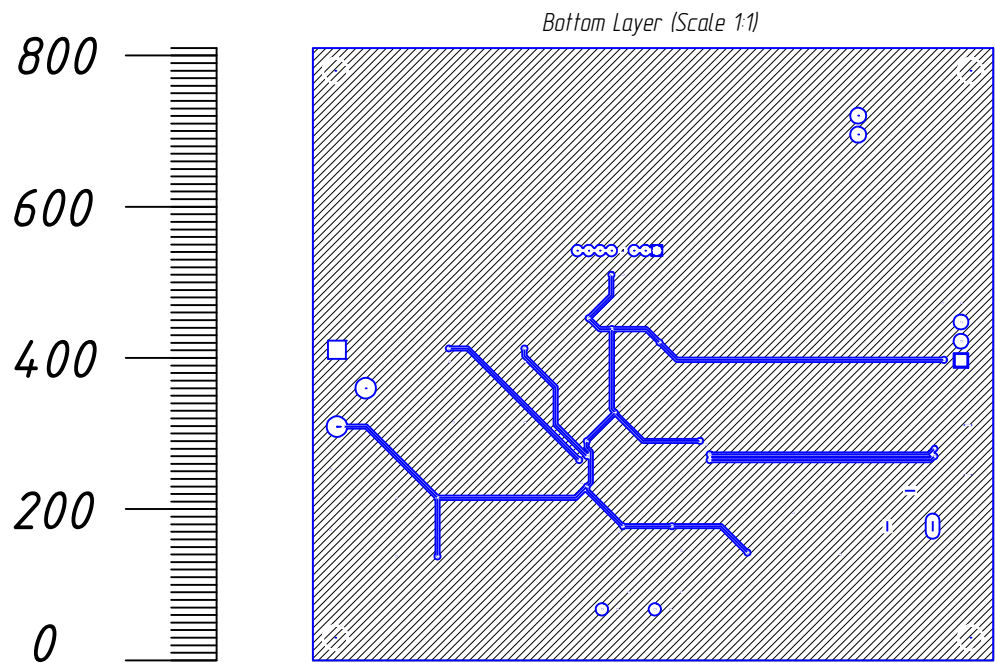
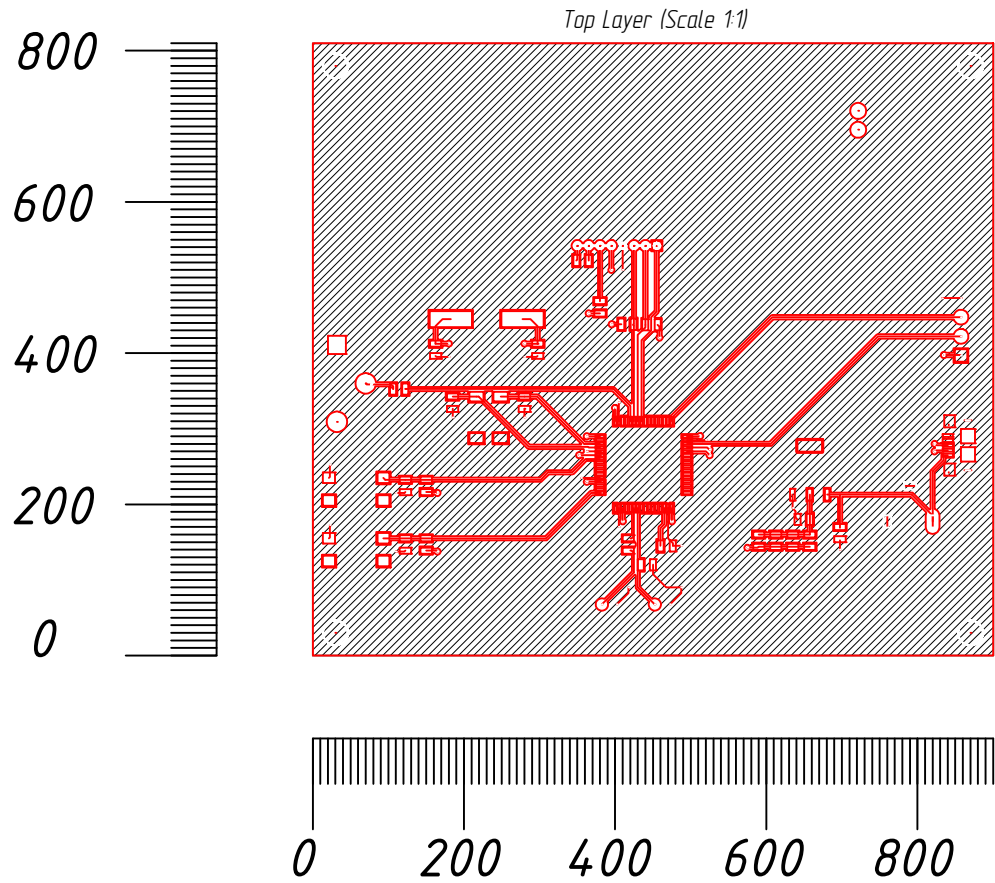
Layer Stack Legend

Material	Layer	Thickness	Dielectric Material	Type	Gerber
	Top Overlay			Legend	GTO
Surface Material	Top Solder	0.01mm	Solder Resist	Solder Mask	GTS
Copper	Top Layer	0.04mm		Signal	GTL
		1.50mm	FR-4	Dielectric	
Copper	Bottom Layer	0.04mm		Signal	GBL
Surface Material	Bottom Solder	0.01mm	Solder Resist	Solder Mask	GBS
	Bottom Overlay			Legend	GBO
Total thickness: 1.59mm					

*Розміри для довідок

1. Крок координатної сітки 0,2 мм. Лінії координатної сітки нанесені через кожні 10 кроків.
2. Плата повинна відповідати ГОСТ 23752-79. III група жорсткості.
3. Конфігурацію провідників витримати за координатною сіткою. Ширина провідників 0,25 мм.
4. Плату виготовити комбінованим позитивним методом по ОСТ 5-9707-88
5. Плата повинна відповідати клас точності 4 за ГОСТ 23 23751-86, або ТУ виробника не нижче класу точності 4.
6. Покрити сплавом Розе чистий ТУ 6-09-4065
7. Параметри отворів наведені у таблиці 2.
8. Параметри контактних майданчиків наведені у таблиці 1.

					ДК 01.758721.001 ДП				
					Плата друкована		Лім.	Маса	
Зм	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата			Д	30г	1:1
Розроб.	Суханов Д.О.								
Перев.	Яганов П.О.								
Т. контр.	Яганов П.О.				Склотекстоліт FR4-4-2-35-1,5 ГОСТ 10316-78		Арк. 1	Аркушів 2	
Н. контр.									
Затв.	Яганов П.О.								
							НТУУ "КПІ" ФЕЛ, зр.ДК-01		



Таблиця 1.

Умовна познака контакт. майданчика	Розміри контакт. майданчика, мм	Наявність заокруглення кутів	Радіус заокруглення кутів, мм	Кількість КМ
□	1.9x1.3	відсутнє	-	4
□	1.6x1.4	відсутнє	-	2
▬	1.35x0.4	відсутнє	-	5
■	0.61x1.549	відсутнє	-	3
-	1.194x0.305	відсутнє	-	64
□	1.5x0.8	відсутнє	-	44
□	1.4x1.6	відсутнє	-	8
□	1.9x1.3	відсутнє	-	4
□	5.6x2.1	відсутнє	-	2
□	1.9x1.9	відсутнє	-	2